

沾胶式173-210度中温固晶锡膏(无铅)

ASADA中的173-210度锡膏是一种无铅无卤的焊锡膏，它采用原日本本土生产的球形无铅焊锡粉和无卤助焊剂。此外，过回流后，该浆料的助焊剂残留透明无卤素，因为它本身不包括卤素。

1. 杰出的特性

采用无铅 (SnBiAgCu系列) 焊料合金。

- 1) 不使用卤化剂
- 2) 连续沾刷时粘度变化小，可印性稳定。
- 3) 高的峰值温度可以保证优异的可焊性。
- 4) 无需清洗，可靠性高。

2. 产品应用

1. 适用于所有焊接电极及基板带镀银层金属的晶体封装。
2. 熔点为173-210度，焊接过后的产品如需要再次回流焊接建议使用我厂的锡铋银、或带铅的锡铅、锡铅银合金锡膏。
3. 如需要使用Sn90Sb10合金进行二次回流焊接，建议用我厂Sn90Sb10Ni0.5进行第一次焊接测试使用。

3. 产品性能

1. 产品性能及成分（未熔化）

项目	规格	数值
主要成分	超微锡粉、助焊剂	6号锡粉 5-15μm
黏度（25℃）	10500cps	Brookfield@10rpm
	150±20 Pa.s(20℃)	MALCOM@10rpm
比重	4	比重瓶
触变指数	4.0	3 rpm （黏度计0.5/3.7rpm）
保质期	3个月	0至10℃保存

产品成分	CAS编号	重量百分比	AGGIH TLV	OSHA PEL	单位
Bi	-	33-37	NE	NE	-
Ag	7440-22-4	0.05-1.05	NE	NE	mg/m3
Sn	7440-31-5	59-65	NE	NE	mg/m3
Cu	7440-50-8	0.005-0.015	NE	NE	-
树脂	65997-05-9	4.0-8.0	NE	NE	-
表面剂	10035-10-5	1.0-5.0	NE	NE	-
活性剂	505-48-6	0.2-0.9	NE	NE	-
有机溶剂	107-21-1	2.0-5.0	NE	NE	-

熔点 (°C)	173-210	°C
热膨胀系数	30	ppm/°C
导热系数	67.59	W/M·K/85°C
电阻率	13	25°C/MΩ·cm
剪切拉伸强度	27	N/mm ² /20°C
	17	N/mm ² /100°C
抗拉强度	45-55	Mpa

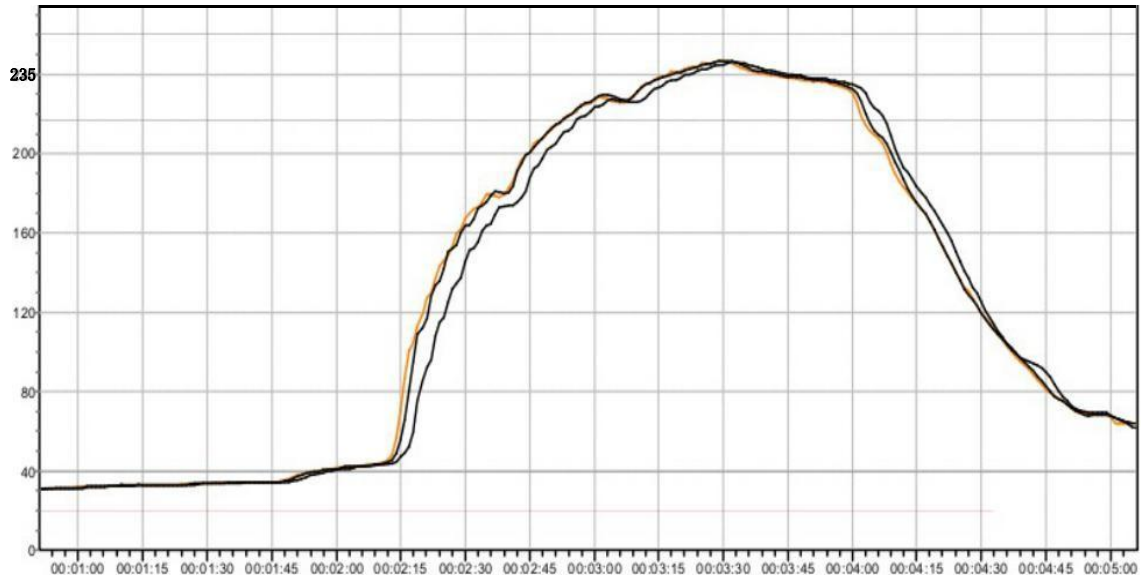
NO	项目	检查标准	判定基准
1	外观	每批	*
2	组成	每批	*
3	卤素含量	每批	*
4	粘度	每批	*
5	可焊性	每批	*

1. 针筒包装：20g /支, 50g /支.
2. 瓶装包装：250g /瓶, 500g /瓶, 4000g /瓶
3. 此产品有带稀释剂，当胶体粘度变稠干时，把胶盘上的锡膏取到容器里，加上锡膏总重量 的 1-3%的稀释剂稀释锡膏，即获得适合的沾胶粘度。
4. 请在以下条件密封保存：温度：0至10°C，相对湿度：35-70%
5. 标签上标有厂名、产品名称、型号、生产批号、保质期、重量。

5. 使用注意事项

1. 请将本产品密封并置于冰箱0至10℃冷藏保存，有效期 3 个月。
2. 使用前，请将产品不拆原包装的情况下放于室温（25℃左右）回温 1-2 小时。
3. 点胶环境和用具、被粘物品等需充分保持清洁、干燥，否则易引起锡膏固化不良。
4. 锡膏使用时如发现有填充物沉淀或发干现象请充分搅拌均匀再使用，若粘度过大， 可用专用的稀释剂，为锡膏重量的 1-3%，但加入量不宜太多，粘度适当即可。
5. 本锡膏启封后请于 3 天内用完，在使用过程中请勿将锡膏长时间暴露在空气中，使用过剩下的锡膏请另用容器放置，不宜再混合到新鲜的锡膏中。

6. 回流曲线附图：



通道	经过时间 T0:160度	升温时间 30-110度	预热时间 110-160 度	回流时间 >=200度	升温 速率, 度/ 秒, 60 -160 度	降温 速度, 度/ 秒, M AX- 90度	最大 升温 率, 度 / 秒	峰值 温度 /度	峰值 温差 /度	超温 报警> 300 度
1	00: 02: 30	00: 01: 40	00: 00: 00	00: 01: 10	7.14	-2.15	0.00	235.0		
2	00: 02: 30	00: 01: 40	00: 00: 09	00: 01: 11	7.69	-2.21	0.00	235	0.6	
3	00: 02: 35	00: 01: 39	00: 00: 10	00: 01: 12	6.67	-2.14	0.00	235		

线速度 MM/Min	温区	温区1	温区2	温区3	温区4	温区5	温区6	温区7	温区8
110	上温区	0	0	0	120	160	235	235	230
	下温区	0	0	0	120	160	235	235	230

*仅供参考！